



PRIORTECH

מצגת שוק הון
מאי 2025



הערות משפטיות

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המיידים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

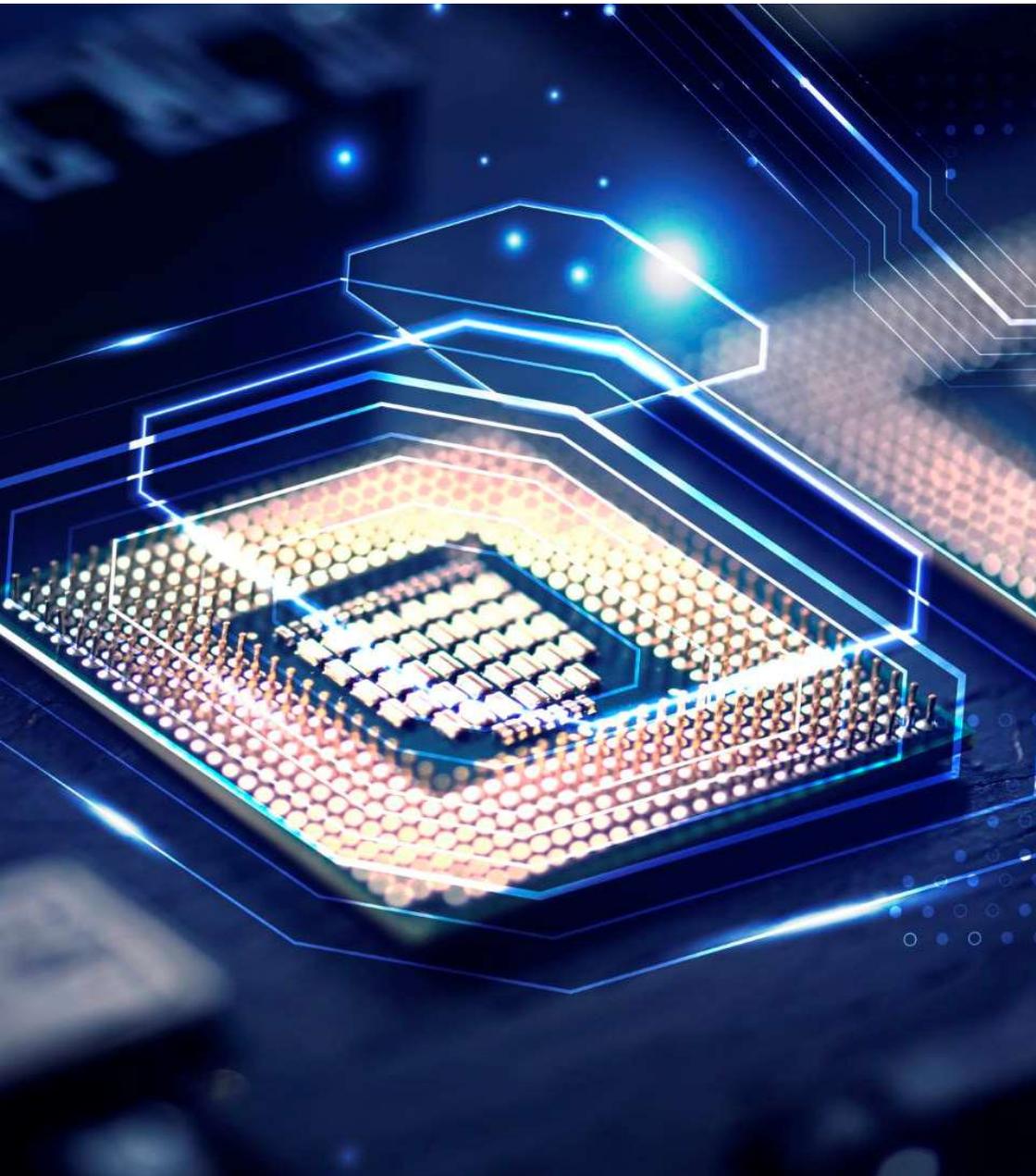
מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועלויות מחירי הובלה, עלויות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים, בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה וסגרים בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגאו-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עלויות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 27.3.2025 (מספר אסמכתא 2025-01-021079).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוך לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.



PRIORTECH

תוצאות Q1-25

Y 2024

\$35.8M

Q1-25

\$8.5M

רווחי
אקויטי

Y 2024

\$35.9M

Q1-25

\$9.2M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו

\$41.4M

הון עצמי

\$256M

תחזית שוק הסמיקונדקטור

**אנליסטיים מעריכים
שתעשיית הסמיקונדקטור
תמשיך לגדול בשנים
הקרובות ותגיע להיקף
מכירות של טריליון דולר עד
סוף העשור**

המכירות העולמיות בענף הסמיקונדקטור גדלו ב- 18.8% ברבעון 1 של 2025 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אולם ירדו ב- 2.8% לעומת הרבעון הקודם.

סגמנט רכיבי ה-HPC ממשיך לצמוח בעיקר עקב התרחבות השימושים של יישומי AI והדרישה לרכיבי חומרה מתאימים לחוות שרתים ולמחשוב קצה יעודי.

הביקושים למוצרי קצה כמו, טלפונים סלולריים, מחשבים אישיים, לא צפויים לגדול בשנת 2025.

מדיניות התעריפים של הממשל האמריקאי, יוצרת חששות ואי ודאות בשוק הגורמות להאטה בצמיחה.

גם בסין הצפי הוא שהצמיחה בשוק הסמיקונדקטור תימשך, בעיקר בתחום ה-HPC.

2025 Market Forecast Update

Forecast as of March 2025:	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	2025
WFE Equipment (\$B):	\$24.0	\$24.9	\$26.8	\$29.2	\$104.9	\$27.1	\$25.9	\$26.6	\$29.1	\$108.7
Sequential Change	-4.0%	4.0%	7.3%	9.1%	6.5%	-7.3%	-4.4%	2.6%	9.5%	3.6%
Fab Utilization:	71.2%	74.5%	76.9%	75.8%	74.6%	73.0%	75.9%	80.8%	83.2%	78.2%
ICs (\$B):	\$129.5	\$139.1	\$153.4	\$163.4	\$585.4	\$159.6	\$171.1	\$178.7	\$174.4	\$683.8
Sequential Change	-0.1%	7.4%	10.2%	6.6%	27.5%	-2.3%	7.2%	4.4%	-2.4%	16.8%
IC Units (BU):	79.0	87.4	97.6	95.2	359.2	90.4	98.0	103.0	96.7	388.1
Sequential Change	-4.5%	10.6%	11.6%	-2.4%	3.8%	-5.1%	8.5%	5.1%	-6.1%	8.0%
Electronics (\$B) :	\$589.4	\$568.4	\$616.7	\$697.0	\$2,471	\$588.0	\$587.4	\$647.9	\$737.3	\$2,561
Sequential Change	-13.8%	-3.6%	8.5%	13.0%	1.6%	-15.6%	-0.1%	10.3%	13.8%	3.6%





תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות



 ACCESS

AMITEC/ACCESS

 PRIORTECH

המצב העסקי של אקסס

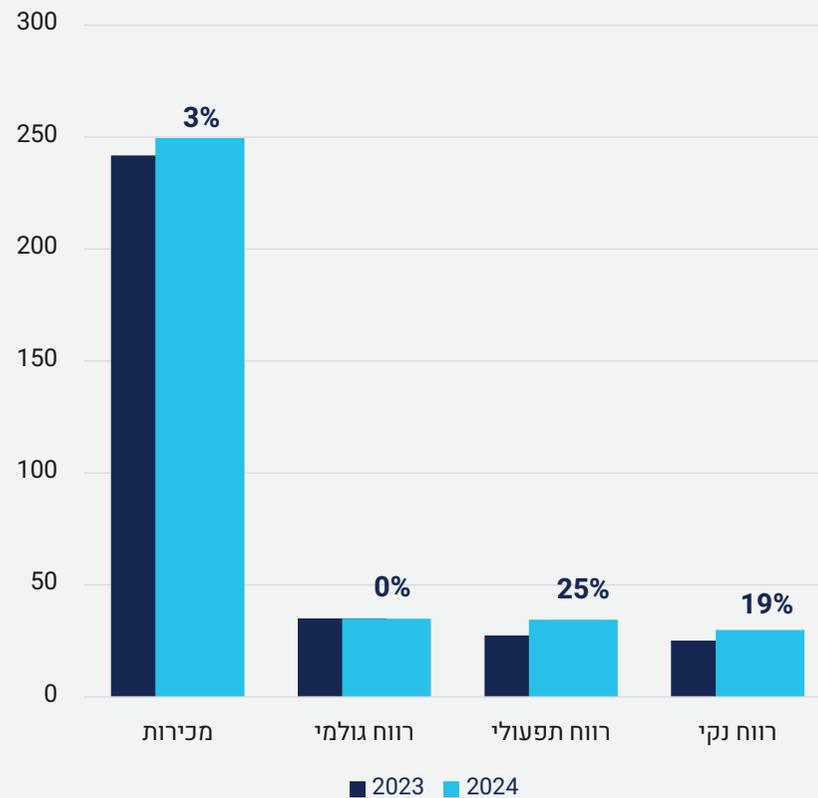
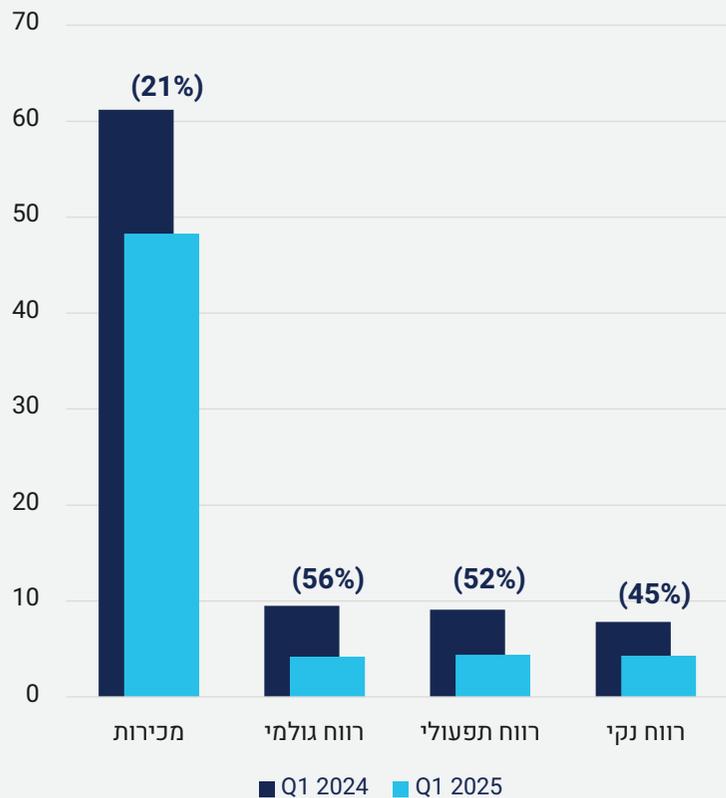
אקסס מעריכה שרמת המכירות בשנת 2025 תהיה דומה לשנת 2024 כאשר רמת המכירות בחצי הראשון של השנה תהיה נמוכה מזו של שנת 2024 אולם בחצי השני רמת המכירות צפויה לעלות ולפצות על החולשה בחצי הראשון של השנה.

תחום רכיבי ה-ECP ממשיך את הגידול גם בשנת 2025 ואקסס מרחיבה יכולות יצור בתחום זה ומבססת אותו כתחום מוביל. מוצרי התחום נהנים מהביקושים הגדלים לרכיבים ליישומי AI.

תחום רכיבי ה-RF סובל מהמיתון בסין ומהביקושים הנמוכים למוצרי צריכה ובעיקר לטלפונים סלולריים. ברבעון זה המכירות בתחום נמוכות, אולם צפויה התחזקות במהלך המחצית השניה של 2025. התאוששות משמעותית של התחום צפויה רק כאשר המיתון במשק הסיני יסתיים ומכירות מוצרי הדגל בשוק הסלולר יתאוששו.

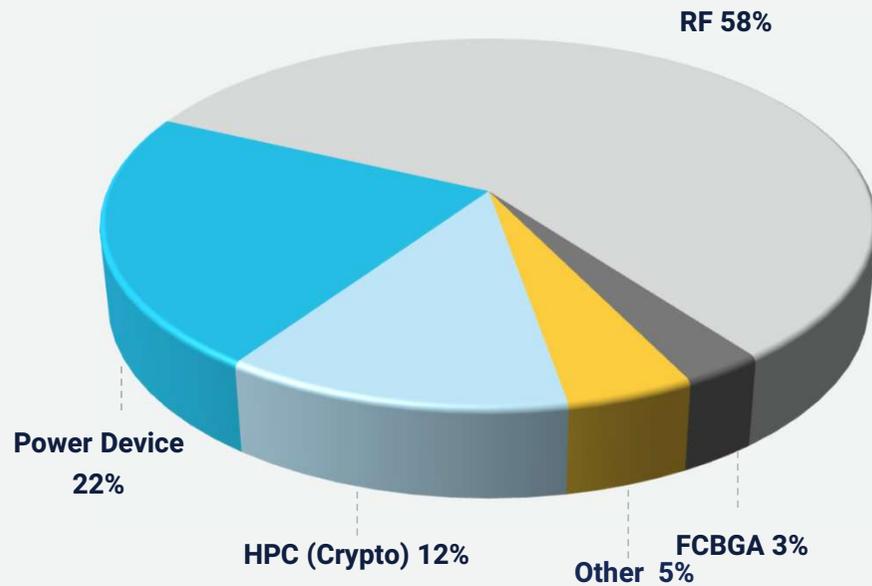
אקסס נערכת להנפקה בבורסה בשנזן. צפויה להגיש את הבקשה לרישום למסחר בסוף חודש יוני 2025. לאחר מכן צפויה לעבור בדיקה מקיפה של הרגולטור הסיני, המוערכת בכשנה, לצורך קבלת האישור לרישום.

אקסס - תוצאות רבעון ראשון 2025

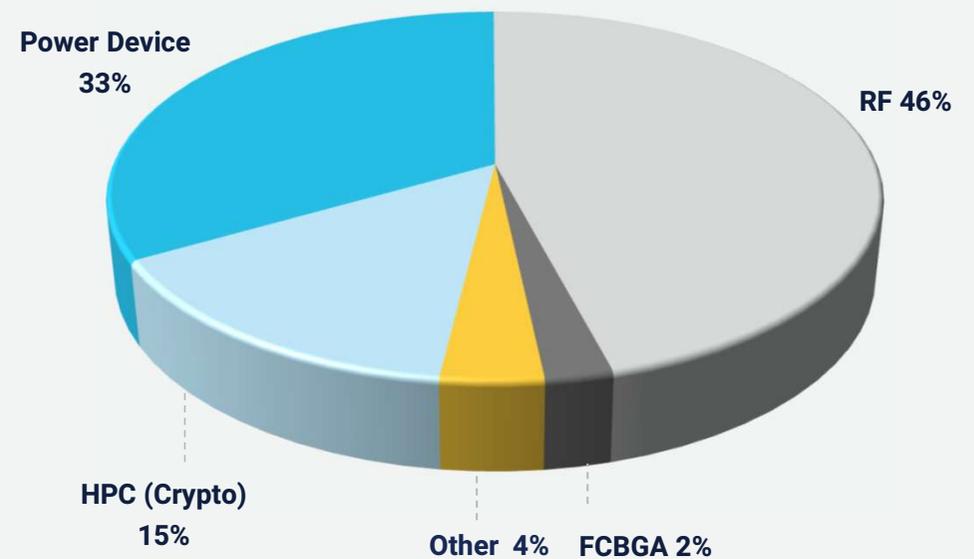


התפלגות סל המוצרים

Y 2024 REVENUE



Q1 2025 REVENUE



Camtek



CAMTEK



המצב העסקי של קמטק

קמטק צופה שתחום הרכיבים עבור המחשבים עתירי הביצועים ה-**HPC** ימשיך להיות **מנוע הגידול העיקרי** של קמטק. מהווה כיום ספק ציוד מוביל בפתרונות לשוק זה.

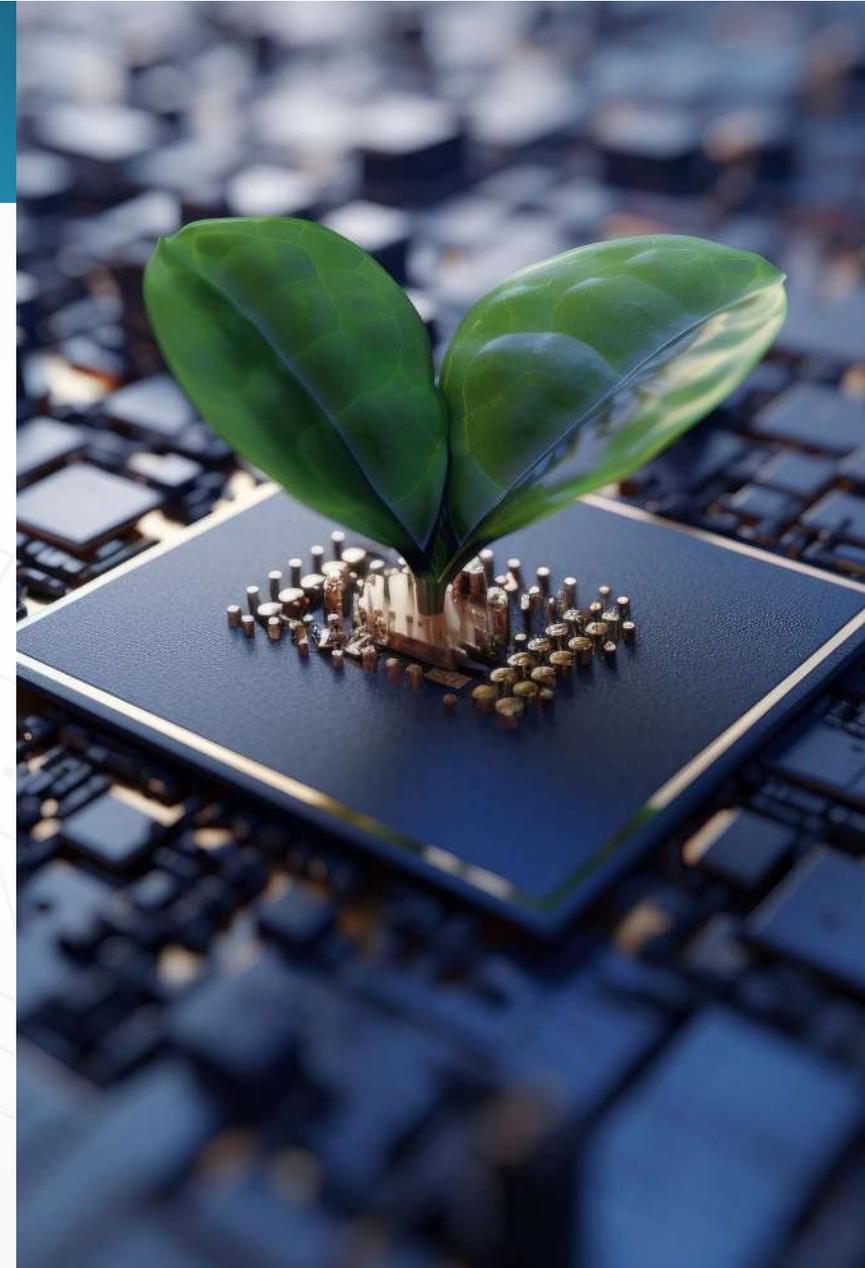


צפי המכירות לרבעון השני של 2025 עומד על כ- 120-123 מיליון דולר, גידול של 17-20% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

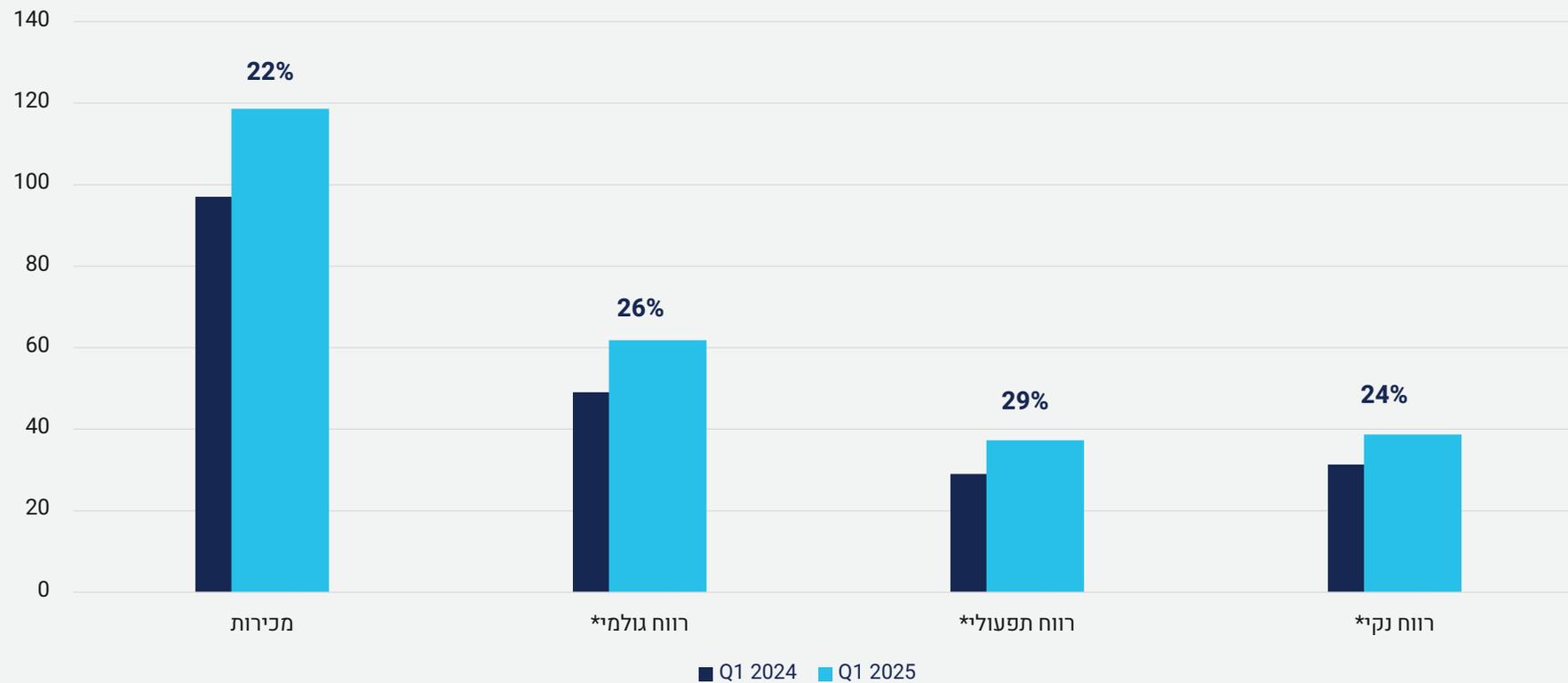
קמטק השיקה בהצלחה שני דגמים חדשים, Hawk ו-Eagle G5. מערכות אלו תומכות בטכנולוגיות היצור החדשות של מארזים מתקדמים.



תחום ה-**HPC** ממשיך להתפתח ומעברים לטכנולוגיות חדשות, כמו מעבר מ-HBM3e ל-HBM4 ודורות חדשים של פתרונות CoWoS, ימשיכו להגדיל את הביקושים בתחום.



קמטק - תוצאות רבעון ראשון 2025



פרפורטק - סיכום



קמטק מעריכה כי תמשיך לחזק את מעמדה בתחום ה-HPC עבור יישומי AI, אשר צפוי כי ימשיך לצמוח בשנים הקרובות, בקצב שנתי של 25-35%. קמטק תמשיך לשרת שווקים נוספים עם פוטנציאל גידול כמו ה-compound semi עבור רכיבי Power devices, בעיקר לתעשיית הרכבים החשמליים, לתחום ה-AP בכללותו ולשאר השווקים אותם היא משרתת היום.

אקסס היא החברה המובילה בסין בתחום המצעים המתקדמים, הנהלת אקסס מעריכה שהמאמץ שסין עושה לפתח את תעשיית הסמיקונדקטור ולהחליף ייבוא של רכיבים לטובת ייצור מקומי, יגרום לביקושים גם למצעים שאקסס מייצרת ויהוו עבודה מנוע גידול.

מונחים מקצועיים

הגדרות

(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני.



(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. אינטל ו-AMD, יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



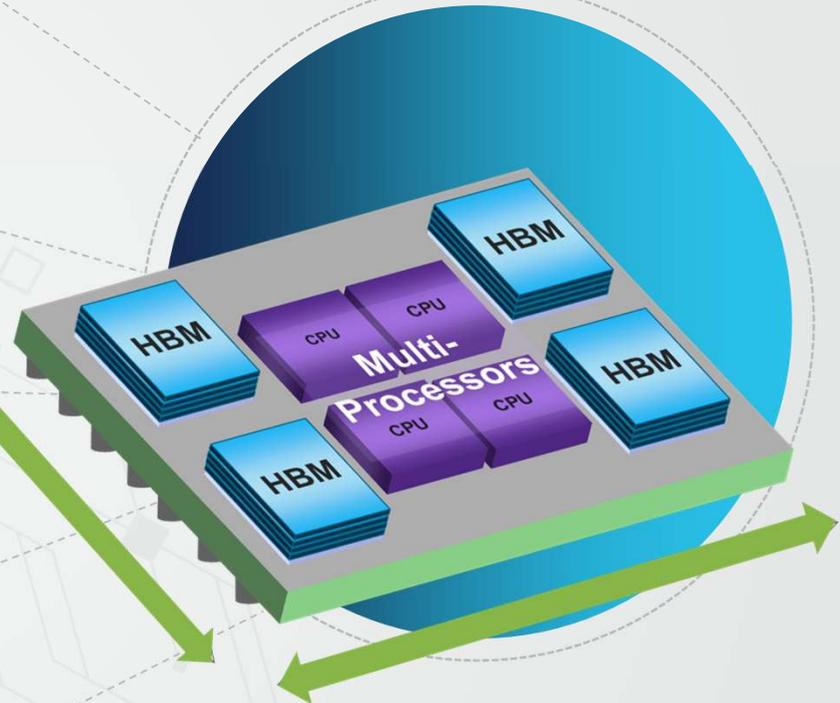
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רוחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.



מונחים מקצועיים הגדרות (המשך)



מארזי ECP

מארזים המכילים רכיבים של Power devices שמונחים על מצע אורגני קבור, החיבור בין הרכיבים נעשה על ידי רשת של מוליכים (RDL) במספר שכבות. המארז הוא חלק מסגמנט ה-Advanced Packaging והוא מוגן במספר פטנטים רשומים שאקסס רשמה



RDL

Redistribution layers - רשת של מוליכים דקים בין 2 ל 12 מיקרון שמחברת בין הרכיבים במספר שכבות של הולכה.



Via First

זו הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה באמיטק ומיושמת באקסס מיום הקמתה, בטכנולוגיה זו החיבור בין השכבות השונות נעשה דרך pillars שמיושמים בתחילה ורק לאחר מכן מניחים את השכבה, להבדיל מהטכנולוגיה הרגילה בה חורי המעבר (Via) נקדחים ומצופים לאחר הנחת השכבה.



PMIC

Power management Interconnect - רכיבי Power Devices הצורכים זרמים גבוהים ונמצאים בסקלה הגבוהה של המחירים והאיכויות.



Pick&place

טכנולוגיה של השמת רכיבים על מצעים בצורה מאוד מדויקת ובתפוקה גבוהה.

